

# 苏州晶方半导体科技股份有限公司

## 【2015】半年度报告摘要

公司代码:603005

公司简称:晶方科技

### 一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 公司简介

公司股票概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	晶方科技	603005
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆佳国	胡泽	
电话	0512-67730001	0512-67730001	
传真	0512-67730008	0512-67730008	
电子邮箱	info@wiscp.com	info@wiscp.com	

### 二主要财务数据和股东情况

#### 2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,890,367,465.94	2,048,489,734.82	-7.72
归属于上市公司股东的净资产	1,602,081,614.56	1,572,291,022.29	1.93
经营活动产生的现金流量净额	79,327,686.71	95,597,906.65	-17.01
营业收入	304,333,407.61	271,576,637.21	12.06
归属于上市公司股东的净利润	69,044,797.25	86,308,894.94	-20.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,927,190.82	79,389,685.91	-32.05
加权平均净资产收益率(%)	4.33	6.45	减少2.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.39	-23.08
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.39	-23.08

#### 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,927,190.82	79,359,685.91	-32.05
加权平均净资产收益率(%)	4.33	6.45	减少21.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.39	-23.08
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.39	-23.08

2.截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股票)持股情况表

单位:股

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系

### 三管理层讨论与分析

2015年上半年公司实现营业收入304,333,407.61元,同比增长12.06%,归属于上市公司股东的净利润为69,044,797.25元,同比减少20.00%。主要原因分析如下:

1.在全球PC、智能手机等市场增速放缓的背景下,2015年上半年行业整体需求疲软,去库存压力较大。受益于12寸产量与生物身份识别芯片出货量的同比增加,公司的营业收入保持增长态势;

2.随着公司对生物身份识别、12寸封装线等新产品与新技术的投入,在拓展公司市场领域、提升公司技术优势与市场规模的同时,公司资产规模不断扩大,机器设备陆续转固,使得折旧等运营费用增加;

3.收购的智瑞达科技相关资产与业务量运营稳定,并将为公司的未来发展奠定良好的资源平台,但并购的协同效应与规模优势的显现尚需时间,相关资产的运营费用仍较高。同时,为提升资源运营效率,公司对收购的部分电子设备、夹具工具等进行了处置,相应增加了本期费用。

#### (一)主营业务分析

##### 1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币			
科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	304,333,407.61	271,576,637.21	12.06
营业成本	166,194,592.87	126,707,915.72	32.21
销售费用	1,277,121.01	596,688.64	114.40
管理费用	88,386,536.69	56,501,194.89	60.70
财务费用	-19,611,464.36	-4,589,447.73	-326.30
经营活动产生的现金流量净额	79,327,686.71	95,597,906.65	-17.01
投资活动产生的现金流量净额	-485,577,405.64	-109,812,483.21	-382.12
筹资活动产生的现金流量净额	-29,703,167.11	614,327,462.42	-109.65
现金及现金等价物净增加额	69,339,236.20	41,749,942.68	66.08

营业收入变动原因说明:封装出货量增加所致

营业成本变动原因说明:封装出货量增加及折旧等运营成本上升所致

销售费用变动原因说明:主要系员工工资、参展费、差旅费增加所致

管理费用变动原因说明:主要系研发费用增加所致

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务等活动支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付购买智瑞达资产价款及支付设备款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期首次公开发行股票募集资金到位所致

研发支出变动原因说明:技术创新、工艺开发提升产生的研发投入增加所致

#### (二)行业、产品或地区经营情况分析

##### 1.主营业务分析、产品情况

单位:元 币种:人民币			
主营业务分行业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
电子元件	304,219,310.21	166,147,632.26	45.39
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
芯片封装	300,430,885.89	165,848,728.46	44.80
设计收入	3,788,424.32	298,903.80	92.11

营业收入变动原因说明:封装出货量增加所致

营业成本变动原因说明:封装出货量增加及折旧等运营成本上升所致

销售费用变动原因说明:主要系员工工资、参展费、差旅费增加所致

管理费用变动原因说明:主要系研发费用增加所致

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务等活动支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付购买智瑞达资产价款及支付设备款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期首次公开发行股票募集资金到位所致

研发支出变动原因说明:技术创新、工艺开发提升产生的研发投入增加所致

#### (三)行业、产品或地区经营情况分析

##### 1.主营业务分析、产品情况

单位:元 币种:人民币			
主营业务分行业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
电子元件	304,219,310.21	166,147,632.26	45.39
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
芯片封装	300,430,885.89	165,848,728.46	44.80
设计收入	3,788,424.32	298,903.80	92.11

营业收入变动原因说明:封装出货量增加所致

营业成本变动原因说明:封装出货量增加及折旧等运营成本上升所致

销售费用变动原因说明:主要系员工工资、参展费、差旅费增加所致

管理费用变动原因说明:主要系研发费用增加所致

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务等活动支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付购买智瑞达资产价款及支付设备款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期首次公开发行股票募集资金到位所致

研发支出变动原因说明:技术创新、工艺开发提升产生的研发投入增加所致

#### (四)行业、产品或地区经营情况分析

##### 1.主营业务分析、产品情况

单位:元 币种:人民币			
主营业务分行业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
电子元件	304,219,310.21	166,147,632.26	45.39
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
芯片封装	300,430,885.89	165,848,728.46	44.80
设计收入	3,788,424.32	298,903.80	92.11

营业收入变动原因说明:封装出货量增加所致

营业成本变动原因说明:封装出货量增加及折旧等运营成本上升所致

销售费用变动原因说明:主要系员工工资、参展费、差旅费增加所致

管理费用变动原因说明:主要系研发费用增加所致

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务等活动支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付购买智瑞达资产价款及支付设备款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期首次公开发行股票募集资金到位所致

研发支出变动原因说明:技术创新、工艺开发提升产生的研发投入增加所致

#### (五)行业、产品或地区经营情况分析

##### 1.主营业务分析、产品情况

单位:元 币种:人民币			
主营业务分行业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
电子元件	304,219,310.21	166,147,632.26	45.39
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
芯片封装	300,430,885.89	165,848,728.46	44.80
设计收入	3,788,424.32	298,903.80	92.11

营业收入变动原因说明:封装出货量增加所致

营业成本变动原因说明:封装出货量增加及折旧等运营成本上升所致

销售费用变动原因说明:主要系员工工资、参展费、差旅费增加所致

管理费用变动原因说明:主要系研发费用增加所致

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务等活动支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付购买智瑞达资产价款及支付设备款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期首次公开发行股票募集资金到位所致

研发支出变动原因说明:技术创新、工艺开发提升产生的研发投入增加所致

#### (六)行业、产品或地区经营情况分析

##### 1.主营业务分析、产品情况

单位:元 币种:人民币			
主营业务分行业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
电子元件	304,219,310.21	166,147,632.26	45.39
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
芯片封装	300,430,885.89	165,848,728.46	44.80
设计收入	3,788,424.32	298,903.80	92.11

营业收入变动原因说明:封装出货量增加所致

营业成本变动原因说明:封装出货量增加及折旧等运营成本上升所致

销售费用变动原因说明:主要系员工工资、参展费、差旅费增加所致

管理费用变动原因说明:主要系研发费用增加所致

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务等活动支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付购买智瑞达资产价款及支付设备款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期首次公开发行股票募集资金到位所致

研发支出变动原因说明:技术创新、工艺开发提升产生的研发投入增加所致

#### (七)行业、产品或地区经营情况分析

##### 1.主营业务分析、产品情况

单位:元 币种:人民币			
主营业务分行业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
电子元件	304,219,310.21	166,147,632.26	45.39
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
芯片封装	300,430,885.89	165,848,728.46	44.80
设计收入	3,788,424.32	298,903.80	92.11

营业收入变动原因说明:封装出货量增加所致

营业成本变动原因说明:封装出货量增加及折旧等运营成本上升所致

销售费用变动原因说明:主要系员工工资、参展费、差旅费增加所致

管理费用变动原因说明:主要系研发费用增加所致

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务等活动支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付购买智瑞达资产价款及支付设备款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期首次公开发行股票募集资金到位所致

研发支出变动原因说明:技术创新、工艺开发提升产生的研发投入增加所致

#### (八)行业、产品或地区经营情况分析

##### 1.主营业务分析、产品情况

单位:元 币种:人民币			
主营业务分行业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
电子元件	304,219,310.21	166,147,632.26	45.39
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
芯片封装	300,430,885.89	165,848,728.46	44.80
设计收入	3,788,424.32	298,903.80	92.11

营业收入变动原因说明:封装出货量增加所致

营业成本变动原因说明:封装出货量增加及折旧等运营成本上升所致

销售费用变动原因说明:主要系员工工资、参展费、差旅费增加所致

管理费用变动原因说明:主要系研发费用增加所致

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务等活动支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付购买智瑞达资产价款及支付设备款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期首次公开发行股票募集资金到位所致

研发支出变动原因说明:技术创新、工艺开发提升产生的研发投入增加所致

#### (九)行业、产品或地区经营情况分析

##### 1.主营业务分析、产品情况

单位:元 币种:人民币			
主营业务分行业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
电子元件	304,219,310.21	166,147,632.26	45.39
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
芯片封装	300,430,885.89	165,848,728.46	44.80
设计收入	3,788,424.32	298,903.80	92.11

营业收入变动原因说明:封装出货量增加所致

营业成本变动原因说明:封装出货量增加及折旧等运营成本上升所致

销售费用变动原因说明:主要系员工工资、参展费、差旅费增加所致

管理费用变动原因说明:主要系研发费用增加所致

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务等活动支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付购买智瑞达资产价款及支付设备款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期首次公开发行股票募集资金到位所致

研发支出变动原因说明:技术创新、工艺开发提升产生的研发投入增加所致

#### (十)行业、产品或地区经营情况分析

##### 1.主营业务分析、产品情况

单位:元 币种:人民币			
主营业务分行业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
电子元件	304,219,310.21	166,147,632.26	45.39
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
芯片封装	300,430,885.89	165,848,728.46	44.80
设计收入	3,788,424.32	298,903.80	92.11

营业收入变动原因说明:封装出货量增加所致

营业成本变动原因说明:封装出货量增加及折旧等运营成本上升所致

销售费用变动原因说明:主要系员工工资、参展费、差旅费增加所致

管理费用变动原因说明:主要系研发费用增加所致

财务费用变动原因说明:主要系利息收入